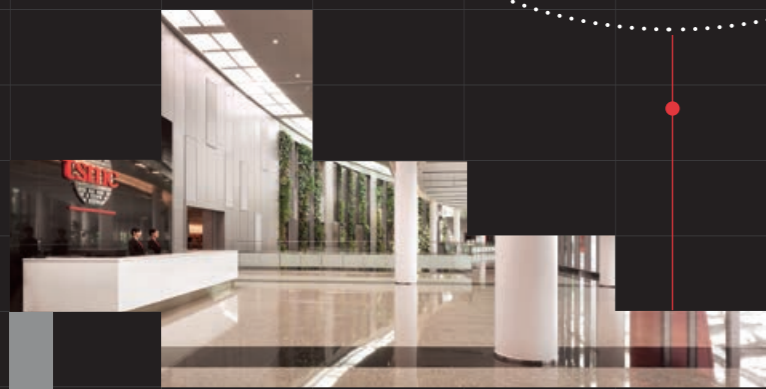
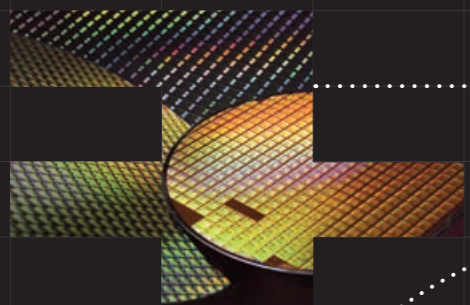


# CHAPTER



# 1

# 致股東報告書

台積公司使命  
作為全球邏輯積體電路產業中，長期且值得信賴的技術  
及產能提供者

## 各位股東女士、先生：

民國一百一十四年對台積公司而言又是強勁成長的一年。我們觀察到人工智慧 (AI) 相關的需求在全年間保持強勁，與此同時，非AI相關的終端市場則已觸底並呈現溫和復甦。民國一百一十四年，全球晶圓製造2.0產業年成長率達16%。憑藉著我們顯著的技術領先及廣泛的客戶基礎，若以美元計，台積公司的營收年增35.9%，並且營收和每股盈餘雙雙創下歷史新高。

民國一百一十四年AI市場持續有非常正面的發展，大型語言模型處理文本的詞元 (token) 數量呈現爆炸式成長，顯示消費端AI模型的採用正在增加。企業AI (Enterprise AI) 也是另一個需求的來源，因為包括台積公司等企業正在內部運用AI來提高生產力和效率，創造更多價值。此外，我們持續觀察到主權AI (Sovereign AI) 需求正日益興起。

因此，我們對人工智慧 (AI) 長期發展趨勢的信念越來越堅定，並且相信市場對於半導體的結構性需求至關重要。

作為晶圓製造服務的提供者，台積公司的首要責任在於提供最先進的技術和充足的產能，全力支持客戶釋放其產品的創新。

台積公司持續投資研發和技術發展以支持客戶的成長。在智慧型手機、高效能運算 (HPC)、汽車及物聯網 (IoT) 應用的驅動下，市場對我們先進製程技術 (7奈米及以下先進製程) 的需求持續強勁。我們的3奈米製程技術已進入量產的第三個完整年度，占台積公司一百一十四年整體晶圓銷售金額的24%。

台積公司的2奈米製程技術於民國一百一十四年第四季成功進入量產，並展現優異的良率表現，我們預期在民國一百一十五年該製程產能將快速攀升。依循我們持續精進製程的策略，我們也推出了N2P和A16製程技術，作為2奈米家族的延伸。N2P在N2的基礎上具備更佳的效能及功耗優勢。A16則採用了業界最佳的超級電軌 (Super Power Rail, SPR) 技術，極適合具有複雜訊號佈線及密集供電網路的特定HPC產品。N2P和A16皆預計於民國一百一十五年下半年進入量產。

A14技術採用台積公司第二代奈米片電晶體結構，將會是比N2更先進的完整節點技術，並且具備效能與功耗優勢，以因應高效能與節能運算日益增長的結構性需求。A14的開發進展順利，預計於民國一百一十七年量產。

我們也持續開發先進封裝和3D晶片堆疊技術，包括CoWoS®、整合型扇出 (Integrated Fan-Out, InFO)、TSMC-SoIC® (系統整合晶片) 和TSMC-COUPETM (緊湊型通用光子引擎)，在可負擔的成本下實現更低功耗的大規模互連，以支持客戶需求。

在成熟製程技術方面，我們與策略性客戶緊密合作，開發滿足其特定需求的特殊製程技術解決方案。這些夥伴關係使我們能夠創造技術差異化，並為客戶提供持久的價值。

我們相信台積公司的先進製程技術、特殊製程技術，以及先進封裝和晶片堆疊解決方案，引領著產業因應對節能運算永無止境的需求，並讓台積公司在未來進一步延續我們技術的領先地位。

為了因應長期市場需求的結構性成長，台積公司在堅守專業紀律的同時，與我們的客戶以及客戶的客戶密切合作以妥善規劃產能。我們著眼於整體潛在市場的大趨勢以決定適當的產能建置，並投資於先進製程、特殊製程和先進封裝技術以支持我們客戶的成長。

這項策略的其中一部分包括根據客戶對地緣彈性的需求以及一定程度的政府支持來擴展我們的全球製造版圖。如此將使台積公司股東價值最大化。

民國一百一十四年三月，我們宣布了一項額外的投資計劃以進一步拓展美國佈局，支援客戶強勁且未來多年度的需求。我們正在美國亞利桑那州取得實質進展，加速產能的擴充，並按計畫順利進行。

我們在亞利桑那州的第一座晶圓廠已經在民國一百一十三年第四季順利以優異的良率成功進入量產；我們正加速第二座晶圓廠的生產計畫，預計於民國一百一十六年下半年進入量產；第三座晶圓廠則已經於民國一百一十四年開始動工興建。

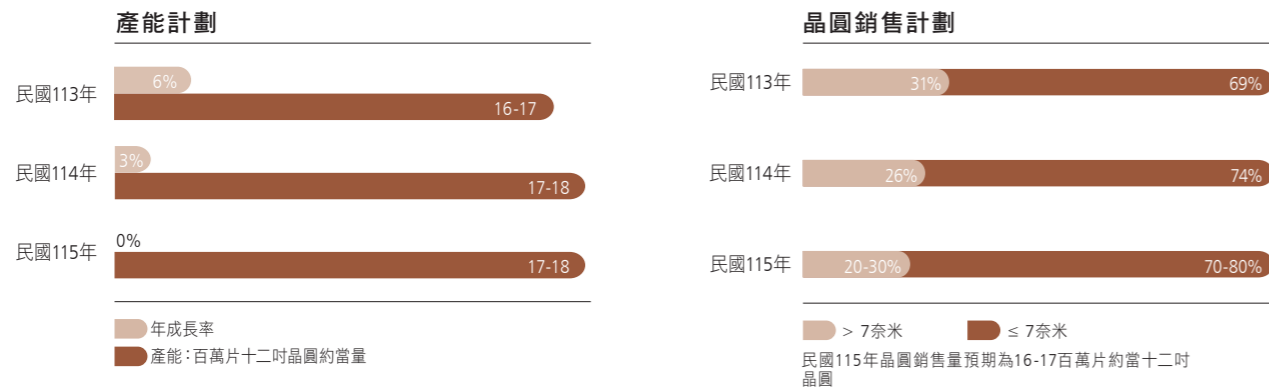
此外，我們也剛在現有廠區附近購得第二塊大面積土地，以支持目前的擴展計劃，並為我們提供更多彈性，以因應非常強勁且多年成長的AI相關需求。

我們的計劃將使台積公司在亞利桑那州擴展成為一個獨立的超大晶圓廠 (GIGAFAB®) 聚落，以支援智慧型手機、AI和HPC應用的領先客戶的需求。

在日本，我們在熊本的第一座特殊製程技術晶圓廠已於民國一百一十三年底以非常好的良率開始量產，目前於熊本興建中的第二座晶圓廠正規劃將採用3奈米製程技術生產，以滿足AI帶動的強勁需求。在歐洲，我們在德國德勒斯登興建的特殊製程技術晶圓廠進展順利，該晶圓廠將專注於汽車和工業應用。

在台灣，我們正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠。未來數年，我們將繼續在台灣的多個地區投資先進製程和先進封裝設施，並高度重視營建現場的安全管理。

透過擴大全球製造布局並持續深耕台灣，台積公司將在未來數年持續作為全球邏輯IC產業值得信賴的技術和產能提供者。



民國一百一十四年，我們在實現永續目標方面也取得了顯著的進展。在四月，我們宣布依循科學基礎減量目標倡議 (The Science Based Targets Initiative, SBTi)，並設定了關鍵里程碑，於民國一百二十九年達成100%使用再生能源，並於民國一百三十九年實現淨零排放的目標。

台積公司民國一百一十四年主要成就包括：

- 晶圓出貨量達1,500萬片十二吋晶圓約當量，民國一百一十三年為1,290萬片十二吋晶圓約當量。
- 先進製程技術 (7奈米及以下先進製程) 的銷售金額占整體晶圓銷售金額的74%，高於民國一百一十三年的69%。
- 提供305種不同的製程技術，為534個客戶生產1萬2,682種不同產品。

## 財務表現

台積公司民國一百一十四年全年合併營收為新台幣3兆8,090億5,000萬元，較前一年的新台幣2兆8,943億1,000萬元增加31.6%；稅後淨利為新台幣1兆7,178億8,000萬元，每股盈餘為新台幣66.25元，較前一年稅後淨利新台幣1兆1,732億7,000萬元及每股盈餘新台幣45.25元均增加了46.4%。

若以美元計算，台積公司民國一百一十四年全年合併營收為1,224億2,000萬美元，稅後淨利為552億1,000萬美元，較前一年度的全年合併營收900億8,000萬美元增加了35.9%，較前一年度的稅後淨利365億2,000萬美元增加了51.2%。

台積公司民國一百一十四年毛利率為59.9%，前一年為56.1%；營業利率為50.8%，前一年則為45.7%。稅後純益率為45.1%，較前一年稅後純益率40.5%增加了4.6個百分點。

台積公司民國一百一十四年現金股利配發總額由前一年度的每股新台幣14.0元提高至每股新台幣18.0元。

## 未來展望

進入民國一百一十五年，儘管總體經濟的不確定性持續存在，我們預期AI相關的需求將持續強勁。憑藉著市場對我們的先進製程、特殊製程和先進封裝技術的強勁需求，我們有信心台積公司的表現將持續優於產業的成長。

展望未來，我們觀察到AI模型在消費端、企業端和主權AI領域的採用率持續提升。這個趨勢帶動了對更多運算能力的需求，進而支持了對先進半導體晶片的強勁需求。

我們正邁入一個AI賦能的世界，人工智慧不僅被運用在資料中心，未來也將應用在個人電腦 (PC)、智慧型手機、汽車，甚至物聯網設備中。

我們的成功奠基於堅守專業積體電路製造服務商業模式，我們將持續就技術與產能等方面進行投資以支持客戶的成長，同時堅持我們的專業領域，確保我們的股東能獲得可持續且穩健的投資回報。

台積公司的使命是作為全球邏輯積體電路產業中，長期且值得信賴的技術及產能提供者。我們將專注於台積公司的業務基礎—技術領先、卓越製造與客戶信任，以進一步強化我們的競爭地位，同時為客戶提供服務，並幫助他們取得成功。

在這個瞬息萬變的世界中，台積公司始終秉持誠信正直、承諾、創新和客戶信任的核心價值來因應各種不確定性。我們從不輕忽自己的責任，並將持續專注於投資技術與產能，以支持客戶的成長、實現獲利成長，並最大化股東價值。感謝您的支持，我們期待未來幾年與您一同成長。



魏哲家

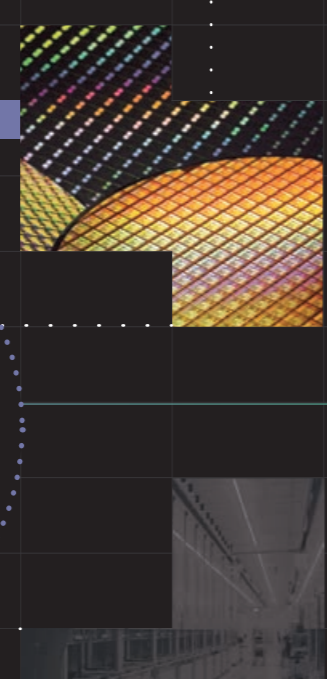
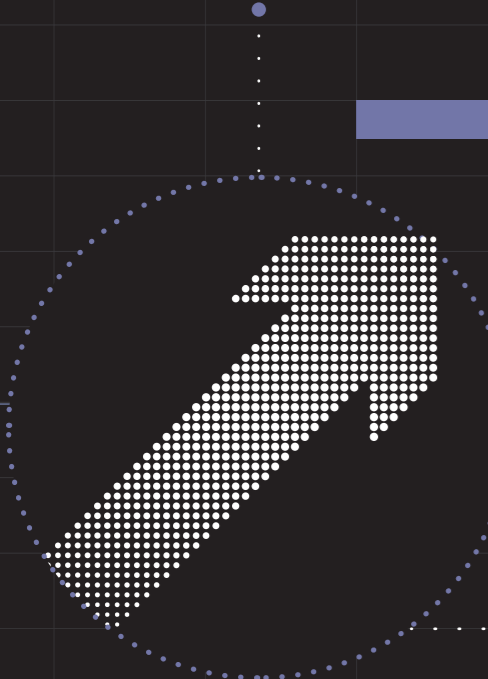
魏哲家  
董事長暨總裁

# 台積公司財務、營運與永續成就

## 財務績效

合併營收新台幣**3兆8,090億5,000萬元**，較前一年增加**31.6%**，創歷史新高

毛利率**59.9%**



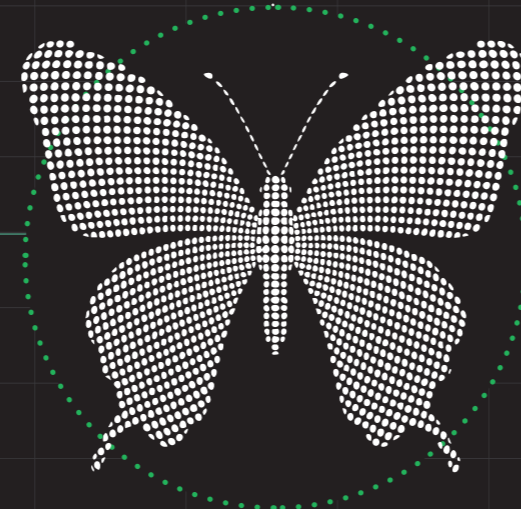
每股盈餘**66.25元**，創歷史新高

現金股利配發總額由前一年度的每股新台幣14.0元提高至每股新台幣**18.0元**

稅後淨利為新台幣**1兆7,178億8,000萬元**，較前一年增加了**46.4%**

## 永續成果

擴大供應鏈減碳補助計畫，補助總額提升至新台幣1.6億元，創造**8萬公噸**減碳效益



全公司生產營運據點 **>20%** 用電量為再生能源

依循科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 承諾減碳目標

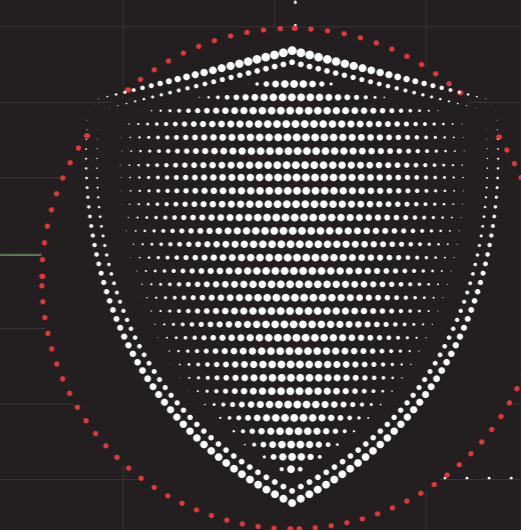


2050年實現淨零排放

獲選道瓊領先世界指數的組成企業，是全球唯一連續**24年**入選的半導體公司

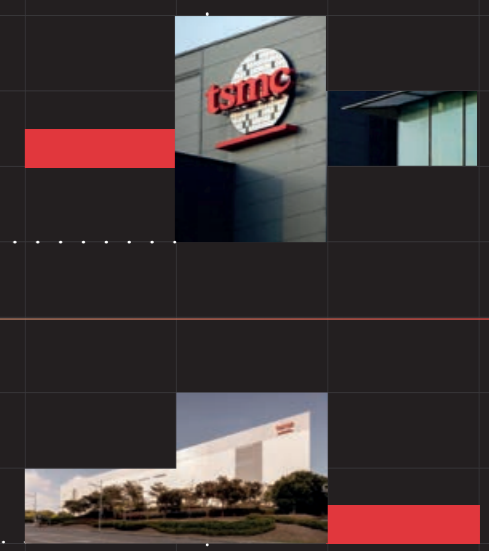
## 營運成就

先進製程技術 (7奈米及以下先進製程) 的銷售金額佔整體晶圓銷售金額的**74%**



提供**305種**不同的製程技術為**534個**客戶生產**12,682種**不同產品

台積公司晶圓出貨量達**1,500萬**片十二吋晶圓約當量



**2奈米**製程技術成功以優異的良率表現進入量產

研發費用達**79億2,000萬**美元

註：原道瓊永續指數；截至2026年3月，道瓊領先指數尚未公告其2025年成分股